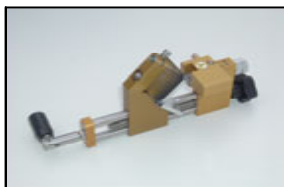


DISPOZITIV PENTRU ÎNDEPĂRTAT STRAT SEMICONDUCTOR EXTRUDAT NEDECOJIBIL CP-P20

Instrucțiuni de utilizare

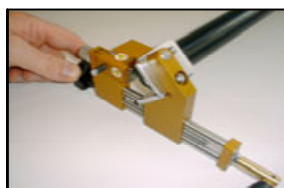
CP-P20 este special proiectată pentru îndepărtarea stratului semiconductor nedecoabil de pe cablurile de M.T. Domeniul de lucru: 10 - 50 mm, diametrul conductorului prelucrat. Avansul automat și tăierea circulară fac ca îndepărtarea stratului semiconductor să fie rapidă și foarte precisă.

- Tăiere circulară.
- Adâncimea de tăiere ajustabilă.
- Cuțitul interschimbabil din carbură de wolfram.



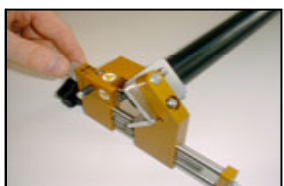
1. Pregătirea conductorului de M.T.

Îndreptați conductorul, curățați bine suprafața acestuia și aplicați silicon industrial pe porțiunea ce urmează a fi prelucrată.



2. Poziționarea sculei pe cablu

Poziționați scula pe capătul cablului și fixați-o cu ajutorul șurubului de strângere.



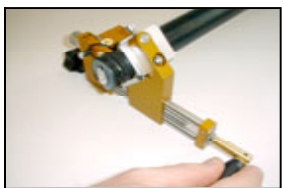
3. Setarea adâncimii de tăiere

Setarea adâncimii de tăiere se face în timpul decojirii, cu ajutorul șurubului amplasat pe partea superioară a sculei. Reglarea adâncimii se face în trepte de 0,1 mm. Adâncimea este corect setată când se îndepărtează în totalitate stratul semiconductor.



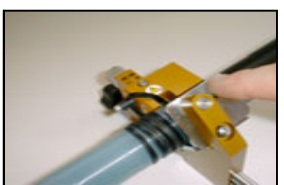
4. Reglajul avansului automat

Reglajul se face cu ajutorul pinului situat pe ghidajul sculei. Setati pinul pe poziția 1 sau 2 pentru avans automat.



5. Procesul de decojit strat semiconductor

Începeți procesul de lucru prin simpla rotire a dispozitivului. Plasați stratul îndepărtat peste deflectorul special conceput. În așa fel obțineți o viteză mai mare de prelucrare.



6. Terminarea procesului de lucru

Îndepărtați stratul semiconductor până pe lungimea dorită. Odată ce ați ajuns la cota dorită setați pinul pentru reglajul avansului la poziția 0 și rotiți o singură dată scula pentru terminarea operației și prelucrarea corectă a muchiei.

